



アルカリ現像型PKG用DFSR AUS SR3

(薄型、コアレスサブストレート対応)

Photo-imageable Solder Resist
for Ultra Thin/Coreless application

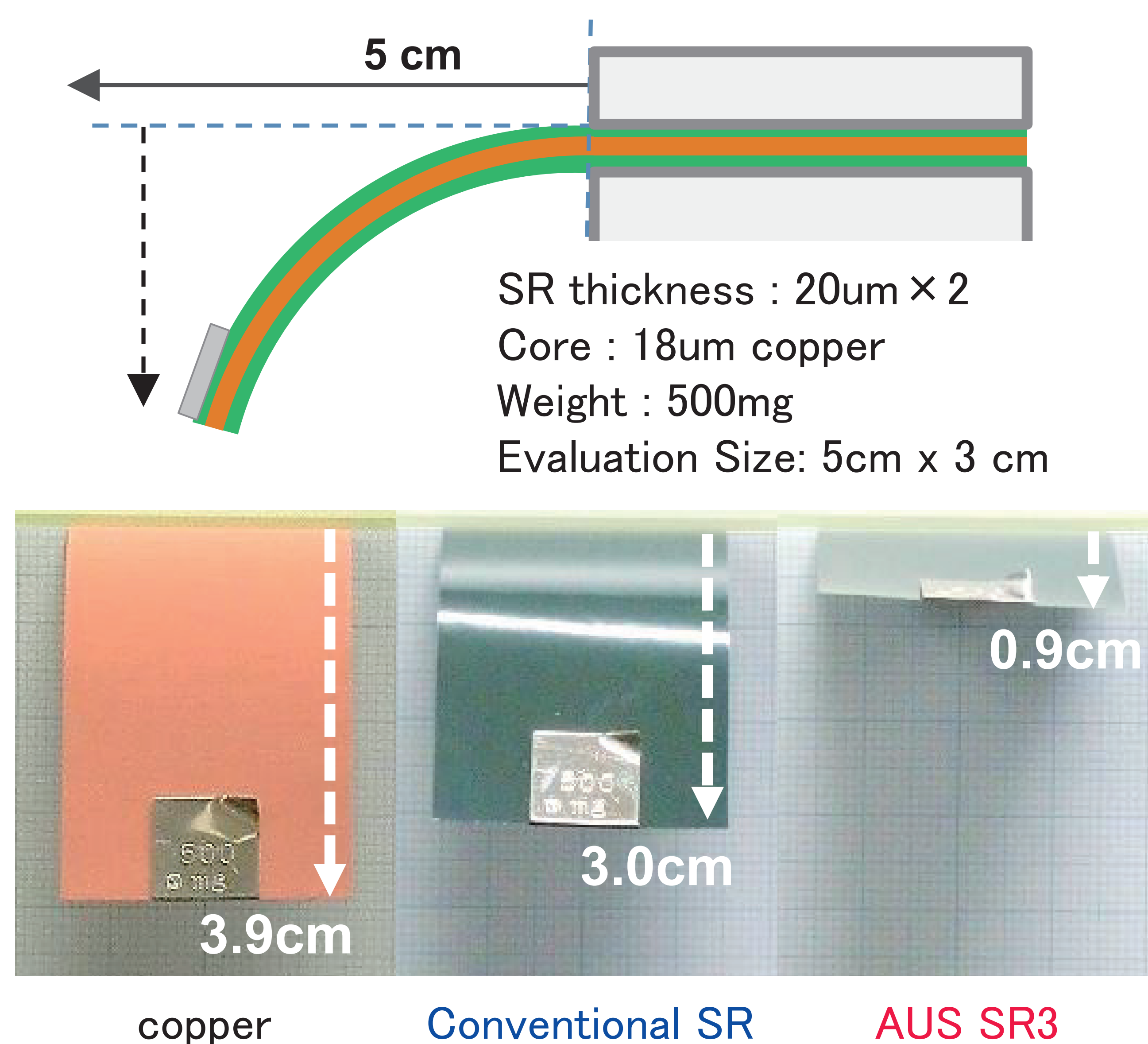
特長 Features

- 高弾性率/高剛性 High Modulus & Stiffness
- 低CTE/ 高Tg Low CTE/ High Tg
- 高強度 High Strength
- 優れた解像性 High Resolution
- ドライフィルムタイプ Dry film type

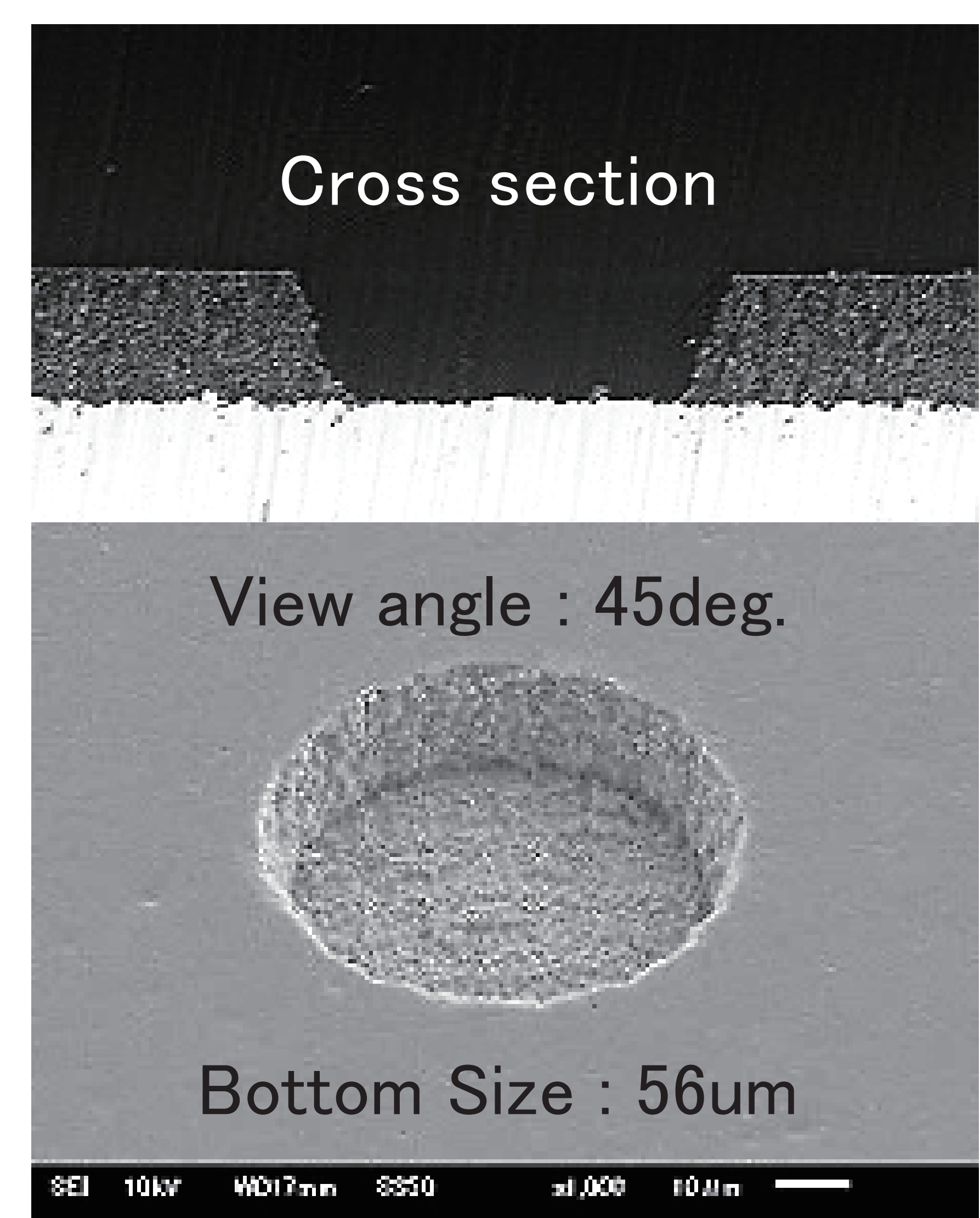
特性 Properties

| | |
|------------------------------------|---------------|
| ガラス転移点 Tg *TMA method | 150-160°C |
| 線膨張係数 CTE ($\alpha 1$) | 15-20 ppm |
| 弾性率 Young's modulus *DMA method | 12.5-13.5 Gpa |
| 破壊強度 Tensile strength | 90-100 Mpa |
| 破壊伸び率 Elongation | 2.0-3.0 % |
| HAST耐性 (130°C/85%RH, 5V,L/S=12/13) | 300h Pass |

Stiffness Test



Resolution



TAIYO INK MFG. CO., LTD.